

公司代码：603316

公司简称：诚邦股份

诚邦生态环境股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年3月6日公司第五届董事会第十七次会议审议通过公司2025年度利润分配方案，鉴于公司2025年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚须提交2025年度公司股东会审议通过后方可实施。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诚邦股份	603316	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	余书标
联系地址	杭州市之江路599号
电话	0571-87832006
传真	0571-87832009
电子信箱	ir@cbgfc.com

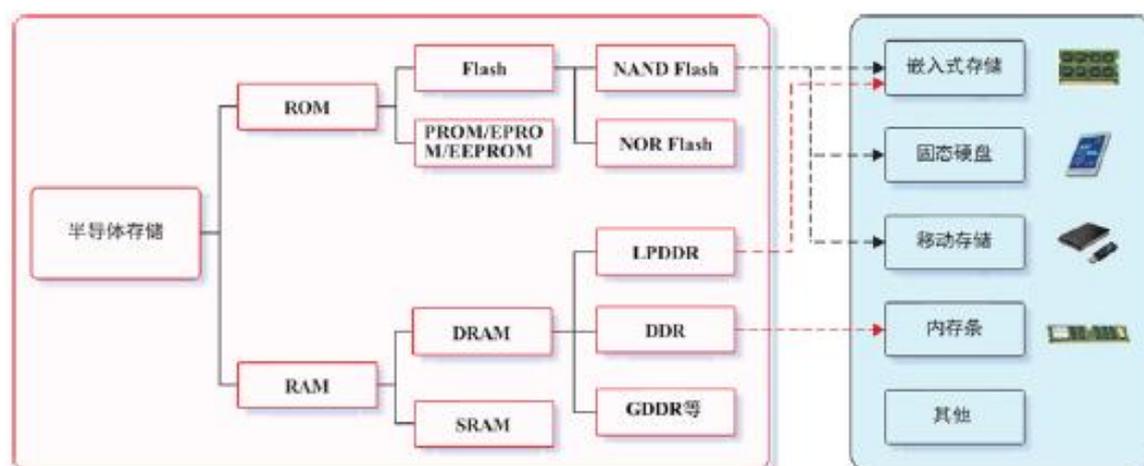
2、 报告期公司主要业务简介

目前公司主营业务涵盖半导体存储业务和生态环境建设业务两大业务板块。

（一） 半导体存储业务

1. 半导体存储行业概况

半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，根据功能的不同，集成电路又可以分为存储器芯片、逻辑芯片、模拟芯片、微处理器等细分领域。存储芯片作为集成电路的关键分支，是现代电子设备中不可或缺的部分，其通过半导体电路存储二进制数据，广泛应用于内存、固态硬盘、U 盘及各种消费电子产品中。存储芯片根据用途的不同可分为主存储芯片和辅助存储芯片，而它们又按照数据在断电后的保存方式分为易失性存储（如 DRAM 和 SRAM）和非易失性存储（如 NAND 和 NOR 闪存）。面向终端用户的存储产品主要分为四大类：嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条。半导体存储器晶圆的主要类型及其相应的存储产品类型如下：



存储晶圆市场高度集中，DRAM 上游主要由 SK 海力士（SK Hynix）、三星电子（SAMSUNG）、美光（Micron）占据大部分市场份额。NAND Flash 上游主要由三星、SK 海力士、美光、闪迪（SanDisk）和铠侠（KIOXIA）等少数企业主导，呈现出寡头垄断的市场特征。

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2025 年全球半导体市场规模约为 7,720 亿美元。其中，存储芯片市场规模约为 2,116 亿美元，占整个半导体市场规模约 27.41%，是半导体产业的重要分支。WSTS 进一步预测，2026 年的半导体市场规模将达到 9,750 亿美元，同比增长超过 25%，逼近 1 万亿美元大关。存储器相关芯片是应用面最广、市场份额占比最高的集成电路基础性产品之一，已成为推动半导体市场发展最为重要的细分行业领域。

2. 公司所处半导体存储产业发展的主要驱动因素

（1） 国家政策鼓励半导体存储产业跨越式发展

近年来，国家出台一系列产业政策，支持包括半导体存储在内的集成电路产业发展。2024 年，国家发改委等六部门发布了《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，提出加强新型存储技术研发，支撑规模化、实时性跨域数据存储和流动，提高智能存储使用占比。2025 年 5 月，工信部印发《算力互联互通行动计划》，提出“提升数据与存储互通能力。推动全局文件系统、智能分层存储、数据压缩与去重等存储技术应用，提升海量非结构化数据的高效承载水平”。2025 年 10 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出“全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。” 基于国家产业政策的支持，将进一步推动关键技术自主可控，带动国内存储厂商跨越式发展，存储模组企业作为中游关键环节的参与者，将持续受益。

(2) AI 下游应用快速发展，推动存储需求激增

人工智能（AI）技术的迅猛发展已成为推动半导体存储市场需求结构性增长的核心驱动力。AI 技术突破正在重塑云服务市场和半导体存储市场格局，在服务器和端侧均有力驱动存储需求全面增长。AI 大型语言模型的推理、训练与应用均依托海量数据，数据中心是支撑云计算、人工智能、机器学习持续迭代和应用的重要核心硬件基础。美光曾表示，典型 AI 服务器的 DRAM 需求量约为普通服务器的 8 倍、NAND Flash 需求量约为普通服务器的 3 倍。同时，AI 服务器数据处理量更大、传输速率要求更高，催生高带宽内存（HBM）在更为广泛的企业级市场中大规模应用，推动半导体存储先进产能扩张，服务器存储市场规模不断扩大。

(3) 半导体存储器正在加速国产化进程

我国是全球半导体存储的主要消费市场，市场规模巨大，但自给率较低，国产存储供应成长空间巨大。根据灼识咨询数据，虽然中国市场存储器需求占比超过 20%，但国产化率低于 30%，全球存储市场仍主要由韩国、美国、日本若干存储 IDM 原厂主导。国家大力推动信创产业发展，力求实现关键信息基础设施领域的软硬件安全和供应链自主可控。以长江存储、长鑫存储为代表的国产半导体存储晶圆产业发展迅猛，国产存储晶圆取得技术突破并快速提升市场份额，预计 DRAM 及 NAND 领域的国产化进程将持续加速，为国内独立存储器厂商的发展带来了更多的契机。

(二) 生态环境建设业务

中国政府在第七十五届联合国大会上提出“2030 碳达峰、2060 碳中和”的目标。2025 年中国城镇化率为 67.89%，和发达经济体 80%左右的水平相比，还有十几个点的提升空间，中国的城镇化仍然处在持续发展过程中。我国加强生态环境治理体系和治理能力现代化建设之路方兴未艾，公司所属行业成长空间广阔。但是，由于地方政府受房地产行业下行等因素影响，地方财政资金

紧张，部分地方政府减少了市政园林相关建设投资，客户支付能力下降，致使项目结算进度放缓、收益下行，机遇与挑战并存。

目前公司主营业务涵盖半导体存储业务和生态环境建设业务两大业务板块。

(一) 半导体存储业务

1、主营业务

公司下属控股子公司芯存科技主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，是国家高新技术企业。公司主要产品包括移动存储（TF CARD 、USB 模块等）、固态硬盘（SATA SSD、PCIe SSD、PSSD 等）、嵌入式存储（LPDDR 等）。公司致力于构筑芯片封测、存储模组产品研发生产一体化的经营模式，布局嵌入式存储、内存条等产品，打造完善的闪存存储产品矩阵，在存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片封测、测试研发等方面打造综合竞争力。

2、主要产品或服务

芯存科技主要产品为半导体存储器，主要包括固态硬盘、移动存储、嵌入式存储等。相关产品广泛应用于消费电子、移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域。公司未来将重点投入可用于大数据中心和服务器的企业级 SSD 等相关产品开发。

(1) 固态硬盘

固态硬盘可以满足大容量存储应用场景需求，固态硬盘产品能够显著提升台式机、个人和商用电脑的性能。固态硬盘主要包括 SSD（固态硬盘）、PSSD（移动固态硬盘）等产品形式，被广泛应用于 PC、数据中心、人工智能、工控、安防、网络终端、医疗、航天、军工等诸多领域。公司目前拥有 M.2、2.5inch 等形态的 SSD 系列产品，除 SATA 接口外，M.2 覆盖 SATA3、PCIe 两种协议接口。产品采用原厂提供的优质 NAND Flash 资源，结合定制化高性能主控和自主固件，在保证兼容性和稳定性的同时，也可实现各类客制化需求。

产品分类	图示	具体产品	应用领域
固态硬盘		PCIeGen4x4M.2SSD	台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、POS 机，广告显示屏
		PCIeGen3x4M.2SSD	台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、POS 机，广告显示屏、网络

			通信、数据中心
		SATA3M.2SSD	台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、网通设备、工业电脑、工业平板、医疗设备、广告机
		SATA32.5-inchSSD	台式电脑、笔记本、Chromebook、游戏设备、POS、广告显示屏、工业电脑、NVR（网络视频录像机）、NAS（网络附属存储器）
		PSSD/移动固态硬盘	数据备份

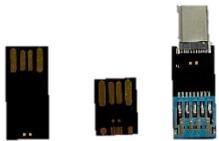
(2) 移动存储

1) 存储卡模组

存储卡是一种利用闪存技术存储数据信息的存储器，其尺寸小巧，外形多为卡片形式，主要应用于手机、GPS 设备、数码相机、无人机、安防摄像头、智能音箱、电子游戏机等消费电子产品中作为存储介质。公司存储管理应用方案广泛支持三星、铠侠、西部数据/闪迪、海力士、长江存储等各家存储原厂的相关存储晶圆产品。

2) 存储盘模组

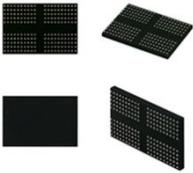
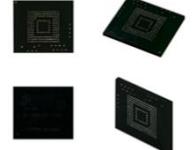
存储盘（U 盘）是一种通过 USB 接口进行数据传输，利用 NAND Flash 存储芯片进行存储的可移动数据存储装置。公司存储盘模组产品方案具有较好的性能和成本优势以及广泛地支持三星、铠侠、西部数据、海力士、长江存储等各家存储原厂的相关存储晶圆产品。

产品分类	图示	具体产品	应用领域
移动存储		U 盘/USB 模块	数据存储、监控设备、电脑、平板消费级场景等

		TF 卡/存储卡	手机、车载应用、中控导航、无人机、相机、监控设备、视频播放器、数据备份、灾备盒、部标机
--	---	----------	---

(3) 嵌入式存储

嵌入式存储广泛应用于智能终端，如智能手机、平板、智能电视、机顶盒等，近年随着智能网联汽车蓬勃发展，自动驾驶辅助系统(ADAS)、智能车载娱乐系统(IVI)、行车记录仪(DASH-CAM)等车用设备也成为嵌入式存储的主战场。公司现拥有 LPDDR、SD NAND 等嵌入式存储产品生产能力且有少量生产，目前已规划增加 LPDDR、EMMC、SD NAND 等产品线，布局车规、工规、商规等领域高耐久特性产品，深入应用场景以满足市场需求。

产品分类	图示	具体产品	应用领域
嵌入式存储		LPDDR	智能手机、平板电脑、超薄笔记本、智能穿戴
		EMMC	智能显示、机顶盒、投影仪、行车记录仪、流媒体后视镜、智能家居、车机
		SDNAND	平板电脑，学习机，机顶盒，智能穿戴设备，游戏机，AI 智能应用设备等

3、主要经营模式

(1) 盈利模式

集成电路行业经过多年发展，英特尔、三星、德州仪器等巨头逐渐形成 IDM (Integrated Device Manufacturing, 集成设备制造) 的经营模式。该模式对企业的技术能力、资金实力、管理组织水平以及市场影响力等方面都有极高的要求。随着芯片制造工艺进步、晶圆尺寸扩大、投资规模增长，集成电路行业趋向于专业化分工，越来越多的企业走向专业化的发展道路，只专注于集成电路的芯片设计、晶圆制造、封装测试三大环节中的某一环节。

公司紧密围绕半导体存储器产业链，构建了芯片封测与存储模组产销一体化的经营体系。公司已制定全面的运营流程，依据市场需求分析精准定位对模组产品进行研发设计，从上游供应商

采购 NAND Flash 晶圆及芯片等核心原材料，对存储介质特性进行深度匹配研究，及主控芯片的选型与定制，通过固件/软件/硬件协同优化与定制化测试方案开发，公司将原材料经 IC 封测及模组制造工艺转化为适配各类应用场景的半导体存储器产品，最终销售给下游客户。

（2）研发模式

公司以市场需求为导向，建立了覆盖新产品开发与存储芯片管理方案优化升级的双轨研发体系。在新产品开发方面，公司专注于技术的迭代与创新产品孵化；在存储芯片管理方案优化升级方面，通过对主控方案迭代、固件参数调整、PCB 布局重构、新型存储芯片适配、既有型号存储芯片优化等核心环节的技术升级，实现产品在运行速度、性能等级、成本控制及市场适应性等方面的系统提升。

（3）采购模式

公司存储产品的核心原材料为存储晶圆。公司在存储模组类产品的生产流程中，所涉及的关键原辅料主要包括存储晶圆、主控芯片及各类辅料。

1) 存储晶圆

存储晶圆属于存储器的核心基础原材料。公司执行按需采购和备货采购相结合的采购策略，参考历史数据，以需求预测为基础设定安全库存，以确保下游供应稳定性；同时结合市场走势、存储晶圆价格波动、库存情况、资金使用安排以及客户订单情况等综合分析，适时进行备货采购，减少上游价格波动对公司经营的影响。

2) 主控芯片及辅料

公司设立专职采购部门负责主控芯片及辅料的采购与管理策略制定及执行。公司建立了合格供应商管理制度并实施动态管理，从技术、品质、交付、服务、成本等各维度对合格供应商实施动态评估与管理。公司以需求预测为基础，结合公司供应链采购备货策略、供应商阶段性报价及产能规划等制定滚动采购计划，进行主控芯片及辅料采购，采购部门根据采购计划，向合格供应商询价、下单及芯片定制，供应商安排生产并交货。

（4）生产模式

公司采用芯片封测与模组产销一体化的经营模式，涵盖芯片封测和模组制造两大核心生产模块：芯片封测生产模块聚焦从晶圆到芯片颗粒的全流程封装测试工序，包括固晶、打线、模压、切割、高温 RDT、测试等工序，所产出的 NAND Flash 芯片颗粒主要为内部模组制造模块提供核心原料，后续也将配套嵌入式存储产品的研发制造。

模组制造生产模块，则重点开展 烘烤、PCB 上线、锡膏印刷、SPI 检测、SMT 贴装、外壳组装及成品测试等工序，主要用于固态硬盘、移动存储等各类终端存储产品的生产制造。公司采购原材料后，对存储介质开展特性研究与匹配，确保多型号方案的兼容性。通过固件/软件/硬件和测试方案开发适配各类客户典型应用场景，管理闪存的擦除、写入操作，提升读写性能和闪存使用寿命。在完成上述流程后，公司进行存储模组制造，将原材料生产成半导体存储器产品，销售给下游客户。

公司会结合市场供需、价格走势等市场情况，以及晶圆良率、规格等级等晶圆质量核心指标，灵活制定适配的生产策略，优化资源配置与生产排期；同时依托全流程自主封测制造能力，可高效响应客户大批量交付、急单交付等多样化交付需求，在保障产品品质的基础上精准把控交期，实现生产经营效益的最大化。自与客户签订订单始，公司启动生产流程。若无需备料，最短一周内即可完成货物交付；若需备料，整个备料及生产过程综合考量约为 30-45 天，届时可确保货物顺利交付。

此外，亦有小部分客户委托公司向其提供存储模组加工服务，客户提供主材，委托芯存科技进行加工，由芯存科技提供辅材，按照上述生产流程进行生产加工，完工交货后向客户收取加工费。





（5）销售模式

根据半导体存储器行业特点及下游客户的需求，通常可采用直销与贸易相结合的销售模式。直销模式下，公司直接与终端客户建立业务合作，并将产品销售给终端客户。贸易模式下，公司以买断式销售的方式向贸易商出货，再由贸易商销售向下游销售。公司通过市场化定价机制，根据产品成本、特性、应用环境、采购规模、客户开发策略及市场行情等因素，与客户协商定价。

1) 直销模式

公司目前主要与下游各细分市场的品牌企业、自营生产类企业等战略客户建立直销合作关系，并安排专门销售人员对接和服务。此类客户对供应链品质要求严格、产品导入验证周期长、门槛高，采购需求规模大且需求较为稳定。公司通过进入其供应链体系，获取长期稳定的订单，并提供定制化产品开发、技术支持及售后服务。

2) 贸易模式

公司严格审慎选择在各细分市场具有广泛销售渠道的贸易商，以买断式销售方式与其进行合作。贸易商凭借自身渠道优势，向下游客户进行销售并提供售后服务，公司为其提供必要的产品技术支持。

（6）管理模式

公司根据专业化运营的要求，构建了完善的公司治理体系，建立了全面覆盖研发、生产、采购、销售和管理的组织机构。公司通过制度体系的建设和完善，对日常经营实现了制度化、流程化和信息化的有序管理。

（二）生态环境建设业务

中国政府在第七十五届联合国大会上提出“2030 碳达峰、2060 碳中和”的目标。2025 年中国城镇化率为 67.89%，和发达经济体 80%左右的水平相比，还有十几个点的提升空间，中国的城镇化仍然处在持续发展过程中。我国加强生态环境治理体系和治理能力现代化建设之路方兴未艾，公司所属行业成长空间广阔。但是，由于地方政府受房地产行业下行等因素影响，地方财政资金紧张，部分地方政府减少了市政园林相关建设投资，客户支付能力下降，致使项目结算进度放缓、收益下行，机遇与挑战并存。

1、主要业务

公司拥有多年的生态环境设计、投资、建设及运营的经验积淀，依托上市公司品牌价值和平台优势深耕主业、稳健经营，公司在行业地位与品牌口碑等方面得到广泛认可。公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级等施工资质，业务扎根长三角地区，并涉足全国多个地区。

公司是目前国内同行业中资质最齐备的企业之一，经过多年不懈努力和探索，在项目承接、建设及运营管理方面积累了较为丰富的经验，在生态环境项目投资、建设、运营能力等方面具备较强优势。

2、经营模式

公司经营业务主要分为销售（项目承揽）、采购、实施及结算等环节。

（1）业务承揽模式：

公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立经营管理中心，与公司相关事业部相衔接，通过公开信息及招标单位邀标等方式获取市场信息，首先对有意向的项目进行充分的尽调，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和投资收益。公司根据经营部门前期获得的项目综合信息，经过分析和研究后，做出是否参与市场竞标的决策，以有效控制项目风险。

（2）采购模式：

公司工程中心负责对供应商进行筛选和考核，对供应商的资信能力、生产实力、管理能力等进行综合评估。公司采购主要有材料采购和劳务采购等，各项目部负责所在项目的物料采购管理

工作，由项目部根据项目工程施工需要提出采购清单，考察和筛选供应商，并进行询价比价，经工程中心确认审批后，确定供应商并签订采购合同。对于项目上急需的材料或零星材料一般经工程中心授权后就近采购。

(3) 实施及结算模式：

针对工程施工项目，公司与业主单位签订合同后，工程管理中心根据项目内容进行统筹管理和任务分配，组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和付款，一般按月或分阶段支付工程进度款，工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工决算手续后支付大部分工程款，剩余部分款项作为工程质保金，于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	2,568,151,976.23	2,728,965,152.75	-5.89	2,868,347,835.73
归属于上市公司股东的净资产	529,154,739.71	649,005,448.56	-18.47	748,478,912.68
营业收入	503,565,473.06	347,893,842.71	44.75	448,359,446.89
利润总额	-82,929,580.76	-85,658,619.18	3.19	-121,000,168.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	501,037,084.70	346,105,461.59	44.76	445,411,468.10
归属于上市公司股东的净利润	-119,598,191.53	-99,473,464.12	-20.23	-108,090,415.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,952,294.32	-105,756,523.35	-8.70	-110,461,318.24
经营活动产生的现金流量净额	138,866,102.75	67,225,173.54	106.57	83,236,293.01
加权平均净资产收益率(%)	-20.30	-14.24	减少6.06个百分点	-13.47
基本每股收益	-0.45	-0.38	-18.42	-0.41

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	-0.45	-0.38	-18.42	-0.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	97,012,235.90	109,837,247.07	98,879,334.83	197,836,655.26
归属于上市公司股东的净利润	2,959,749.43	-13,397,295.79	3,185,117.36	-112,345,762.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,519,572.36	-13,821,612.72	3,117,305.35	-106,767,559.31
经营活动产生的现金流量净额	11,626,718.66	55,894,680.87	990,068.03	70,354,635.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		16,208					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		15,094					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
方利强	0	78,272,222	29.62	0	质 押	46,200,000	境内 自然 人
李敏	0	22,648,684	8.57	0	质 押	13,500,000	境内 自然 人

上海期期投资管理中心(有限合伙)一期期高地六号私募证券投资基金	-1,300,000	11,913,200	4.51	0	无	0	境内非国有法人
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一融通5号证券投资基金	-6,917,216	6,613,100	2.5	0	无	0	境内非国有法人
深圳市前海方位投资管理有限公司一方位投资优选私募证券投资基金	2,719,210	2,719,210	1.03	0	无	0	境内非国有法人
吴化文	-349,970	2,650,087	1	0	无	0	境内自然人
深圳市前海方位投资管理有限公司一方位成长私募证券投资基金	2,041,600	2,041,600	0.77	0	无	0	境内非国有法人
深圳市前海方位投资管理有限公司一方位3号私募证券投资基金	1,931,447	1,931,447	0.73	0	无	0	境内非国有法人
陈晓曼	1,887,500	1,887,500	0.71	0	无	0	境内自然人
顾兆中	1,847,900	1,847,900	0.7	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人李敏为方利强之配偶,方利强和李敏分别持有公司29.62%和8.57%的股份						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年，公司管理层围绕公司战略和经营计划开展工作，围绕“半导体存储+生态环境建设”双主业发展，生态环境建设业务收缩，半导体存储业务作为突破业务，现已是公司营业收入和利润的主要来源，成为公司的核心业务。

（一）半导体存储业务适度扩张，成为公司核心业务

1、形成一体化经营模式

芯存科技已迁入新厂房，完成对封测业务和模组生产业务的资源整合，形成芯片封测与模组产销一体化经营模式。

2、满足客制化产品开发需求，巩固市场地位

公司始终将客户需求放在首位，持续关注市场动态，积极参与各种行业交流活动，了解最新技术发展趋势，以满足客户在不同应用场景下的特殊要求。公司不断提升固件开发水平，充分利用内部技术资源，实现技术的快速迭代和产品的创新，为客户量身定制适合其特定应用需求的解决方案，为客户提供更优质的存储产品，进一步巩固市场地位。

3、建设研发队伍，不断提升技术创新能力

公司深耕存储主业，依托既往积累的技术优势，全力推进研发队伍建设，积极引进嵌入式存储等专业研发人才，持续加大研发投入，储备核心技术。同时，公司将敏锐洞察前沿技术动态和行业发展趋势，巩固并提升技术创新能力。

4、提升封装测试能力，布局高端存储产品

公司已积累了一定的存储芯片封装测试技术和产能，公司陆续引进相关专业人才、购置封装测试先进设备，提升自有封装测试技术和产能，以生产制造为依托提升封装测试的技术实力和自有产能，为产品创新提供助力。公司在现有移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等产品线基础上，已开始布局和拓宽嵌入式存储、内存条等产品线。公司将积极进行资源整合，布局更高端的存储产品，提升综合竞争力。

（二）寻求外延合作，往产业链上游延伸

2025年，公司参股投资忆芯科技，同时与忆芯科技合资设立诚芯智能（杭州）科技有限公司，公司认缴550万元持股55%。公司将以芯存科技芯片封测、存储模组研发生产为基础，通过与忆芯科技合作，整合相关资源，尝试往产业链上游延伸布局主控芯片、企业级SSD、内存条等业务，拓宽业务渠道和产品矩阵，提升公司技术水平和研发能力。

（三）生态环境建设业务在适度收缩中稳定运营

2025年，公司生态环境建设业务已经执行适度收缩的策略，不追求项目订单数量和规模，落实存量项目的竣工验收、审计等各项收尾工作，积极争取各项目尽快回款，优选新项目，以控制风险为主。

针对工程施工项目，注重项目成本费用管控，节约各项开支，并注重项目现场管理，严格把控工程质量关，强化现场管理人员品质意识，维持公司品牌形象。同时，公司从制度和流程上加强现金流管理，通过多种方式强化对应收账款的管理、催收和清理工作。

针对运营类 PPP 项目,公司项目运营团队按项目运营绩效考核目标要求做好项目运营组织管理,有效控制运维成本,提高运维效率。公司重点抓项目可用性付费及运营服务费的收款,在现金流和运营收益方面为公司的经营发展提供有力支撑,保持生态环境建设业务在适度收缩中稳定运营。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用